

シェイパル Hi Msoft

マシナブルセラミックス (AlN+BN 複合焼結体) / トクヤマ / 切削加工用 丸棒・板

切削加工できるマシナブルセラミックス。高熱伝導と高電気絶縁を両立し、真空特性・低熱膨張にもすぐれる

物性値 (メーカー公開データ)

項目	測定条件	試験規格	単位	値
密度	—	—	g/cm ³	2.88
曲げ強度	—	—	MPa	300
熱伝導率	—	—	W/(m・K)	92
体積抵抗率	常温	—	Ω・cm	1.0×10 ¹⁵
絶縁破壊電圧	—	—	kV/mm	65
最高使用温度 (真空中)	—	—	℃	1,900
最高使用温度 (大気中)	—	—	℃	1,000
切削加工	—	—	—	可能

当社の取扱仕様

項目	内容
取扱形状	板／丸棒
色	白
丸棒 外径	10～40 mm (5品目)
板 厚み	5～40 mm (6品目)
外皮	少し黄色掛かった白
仕上げ	研削目、アズファイア品の場合大きな凹凸有り／研削目
寸法公差	板厚公差: -0.0mm～次の規格サイズまで / 長さ公差: -0.0mm～+10.0mm / 外径公差: -0.0mm～次の規格サイズまで / 長さ公差: -0.0mm～+10.0mm
取扱点数	11品目 / 11サイズ
販売単位	1本・1枚から。長さ・寸法のオーダーカットに対応

掲載数値は参考値です。保証値ではありません。これらの数値はメーカーが公開している技術資料からの転記であり、測定規格・試験片形状・ロットにより変動します。設計・採用のご判断にあたっては、必ずメーカー発行の最新データシートでご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。本表の数値に基づく判断により生じた損害について、弊社は責任を負いかねます。

出典: マシナブルセラミックス「シェイパル® Hi Msoft」製品ページ (トクヤマ)

https://www.tokuyama.co.jp/products/advanced_materials/hi_msoft.html 取得 2026-08-26

※メーカーの詳細パンフレットは申請制のため未入手。公開されている代表値のみ掲載